

中信证券股份有限公司

关于

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年八月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明	1
目 录	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人基本信息	3
二、发行人主营业务	3
三、发行人核心技术和研发水平	5
四、主要经营和财务数据及指标	8
五、发行人存在的主要风险	9
第二节 本次证券发行情况	16
一、本次证券发行基本情况	16
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	16
三、保荐人与发行人的关联关系	18
四、保荐人内部审核程序和内核意见	19
第三节 保荐人承诺事项	21
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见	22
一、推荐意见	22
二、本次发行履行了必要的决策程序	22
三、发行人符合科创板定位要求	23
四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件	27
第五节 上市后持续督导工作安排	30

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

英文名称：Xi'an ESWIN Material Technology Co., Ltd.

注册地址：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室

有限公司成立日期：2016 年 3 月 16 日

股份公司成立日期：2023 年 3 月 15 日

统一社会信用代码：91110302MA00475L1K

注册资本：350,000.00 万元

法定代表人：杨新元

邮政编码：710114

联系电话：029-6827 8899（分机号：6927）

传真号码：029-6827 9537

互联网址：<https://www.eswinsi.com>

电子信箱：ir@eswinsi.com

二、发行人主营业务

秉持“成为半导体硅材料领域受人尊敬的伟大企业”的长期愿景，报告期内公司始终专注于 12 英寸硅片的研发、生产和销售。基于 2024 年月均出货量和截至 2024 年末产能规模统计，公司均是中国大陆第一、全球第六的 12 英寸硅片厂商，前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为 6%和 7%。同时，截至 2024 年末，公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。公司产品已用于 NAND Flash/DRAM/Nor Flash 等存储芯片、CPU/GPU/手机 SOC/嵌入式 MCU 等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS 等可实现数据计算、数据存储、数据传输、人机交互等核心功能的多品类芯片的量产制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车和机器人等人工智能时代下的各类智能终端。

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。12 英寸硅片是目前业界最主流规格的硅片，根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球所有规格硅片出货面积的 75% 以上。尤其是人工智能时代需要更强的数据算力、更快的数据传输、更大的数据存储和更灵敏的人机交互，而用于实现前述功能的市场最主流、技术最先进的逻辑和存储芯片（一般 90 纳米工艺制程以下）以及部分高端模拟和传感器芯片均采用 12 英寸晶圆制造工艺，12 英寸产能是目前全球晶圆厂扩产的主流方向，未来 12 英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。12 英寸硅片全球寡头垄断格局已持续多年，2024 年全球前五大厂商供货占比约 80%，而我国 12 英寸晶圆厂产能全球占比预计 2026 年将超过 30%，这一自给结构矛盾对我国半导体产业链的发展形成制约。公司在进入该领域之初即制定了 2020 至 2035 年的 15 年战略规划，计划到 2035 年打造 2 至 3 个核心制造基地，建设若干座现代化的智能制造工厂，聚焦技术力、品质力和管理力，成为半导体硅材料领域头部企业，服务全球客户。

截至本上市保荐书签署日，公司首个核心制造基地已落地西安，该项目第一工厂已于 2023 年达产，本次发行上市募投项目的第二工厂已于 2024 年正式投产，计划 2026 年达产。截至 2024 年末，公司合并口径产能已达到 71 万片/月，全球 12 英寸硅片同期产能占比已约 7%。根据 SEMI 统计，2026 年全球 12 英寸硅片需求将超过 1,000 万片/月，中国大陆地区需求将超过 300 万片/月。通过技术革新和效能提升，公司已将第一工厂 50 万片/月产能提升至 60 万片/月以上，2026 年第一和第二两个工厂合计可实现 120 万片/月产能，可满足届时中国大陆地区 40% 的 12 英寸硅片需求，公司全球市场份额预计将超过 10%。

截至 2024 年末，公司已通过验证的客户累计 144 家，其中中国大陆客户 108 家，中国台湾及境外客户 36 家；已通过验证的测试片超过 390 款，量产正片超过 90 款，其中中国大陆客户正片已量产 80 余款，中国台湾及境外客户正片已量产近 10 款，2024 年量产正片已贡献公司主营业务收入的比重超过 55%。目前，公司实现了国内一线逻辑晶圆代工厂和存储 IDM 厂大多数主流量产工艺平台的正片供货，已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商，已成为目前国内新建 12 英寸晶圆厂的首选硅片供应商之一。公司不仅立足国内需求，更放眼全球市场。目前，公司已向客户 D、联华电子、力积电、客户 P、客户 O、格罗方德等大

多数中国大陆以外主流晶圆厂批量供货。报告期各期，公司外销收入占比稳定在 30% 左右。公司已从全球 12 英寸硅片的新进入“挑战者”快速成长为颇具影响力的“赶超者”。

三、发行人核心技术和研发水平

公司高度重视自主研发和知识产权保护，进入该领域之初即对全球前五大厂商近 30 年的半导体硅片专利全面检讨，制定差异化技术路线。目前，公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平。公司产品已量产用于 2YY 层 NAND Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片；更先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的 12 英寸硅片均已经在主流客户验证。人工智能高端芯片领域，除了公司正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外，公司也在同步配合客户开发下一代高端存储芯片，相应产品可用于 AI 大模型训练和推理数据的实时处理，可用于 AI 大模型训练数据和模型参数的定制化存储需求。截至 2024 年末，公司已申请境内外专利合计 1,635 项，80%以上为发明专利；已获得授权专利 746 项，70%以上为发明专利。公司相应专利均围绕 12 英寸硅片。截至 2024 年末，公司是中国大陆 12 英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商。

公司曾主持陕西省科技重大专项课题“12 英寸高端抛光硅片及成套工艺技术开发”，且先后荣获多项国家及省部级奖项。

公司实施骨干员工股权激励，将核心技术人员与研发团队中的骨干人员引入员工持股平台，充分调动研发团队的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，员工与股东的利益共享、风险共担、事业共创，促进公司的可持续发展。

公司核心技术覆盖 12 英寸硅片生产的所有工艺环节，基于外购和自研的工艺设备已形成独立自主的包括 IP、专利、Know-How 的技术路线和技术体系，目前已达到国际同业同等水平，均有专利和技术秘密保护。具体如下：

核心技术名称	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	已授权发明专利数量	技术先进性
无缺陷晶体生长技术等	自主	拉晶工艺	量产	143	国际同业同

翘曲和弯曲控制技术等	研发	成型工艺		104	等水平
硅片表面平坦度控制技术等		抛光工艺		85	
表面污染控制技术等		清洗工艺		58	
外延设备基座、反应腔室改善设计等		外延工艺		56	

（一）无缺陷晶体生长技术

晶体的原子排列缺陷会影响芯片的栅氧化层，导致芯片出现短路失效，尤其是用于 NAND Flash 和 DRAM 等存储芯片制造的抛光片产品，由于缺少外延层掩瑕，原生晶体的无缺陷是其核心品质要求。公司无缺陷晶体生长技术是指通过自主设计的热场和自主研发的拉晶工艺，使得生长出的晶体原生缺陷尺寸控制在 10 纳米以内，最终硅片的氧化诱生层错数量控制在每平方厘米 1 个以内。

公司无缺陷晶体生长技术具体包含：1）建立晶体生长理论模型，模拟晶体生长过程的熔体对流，热量和杂质的输运，计算不同工艺下杂质和缺陷的分布，为拉晶设备热场设计及工艺调试提供理论支持；2）自主设计拉晶设备的热场，优化晶体生长涉及的固液界面形状、扩充无缺陷晶体生长的工艺窗口，提升晶体含氧量分布的均一性；3）优化拉晶控制系统，通过优化籽晶转速、晶棒拉速、生长温度反馈等多个参数的控制精度，提升晶体生长的工艺控制水平；4）建立多种检测方式结合的晶体缺陷综合评价体系，可实现在晶棒段的硅片全口径缺陷分析，为持续提升无缺陷晶体占比提供快速评价依据。

（二）翘曲和弯曲控制技术

硅片的几何形貌是影响芯片制程的关键指标，代表性量化指标为硅片的翘曲度（表征硅片不同区域的最大翘曲程度）和弯曲度（表征硅片整体的弯曲程度）。随着芯片制程升级以及 3D 结构的堆叠层数增加，对硅片几何形貌要求越来越高，硅片加工的成型和抛光工艺决定了硅片的几何形貌。

发行人的翘曲和弯曲控制技术包含：1）多线切割工艺技术：通过对不同结构切割线 and 不同粒型粒径砂浆的配比，结合切割线的张力调控、进给/送线速度调控及切割液流量等工艺参数的调控，提升硅片切割形貌；2）研磨工艺技术：通过调试研磨定盘的转速，精准控制研磨压力，调整研磨颗粒和砂浆的配比，控制硅片与定盘及载具间的摩擦应力，降低研磨损伤，优化硅片纳米形貌；3）抛光工艺：通过对定盘、抛光垫和硅

片之间的间隙微调以及定盘的温度和形貌的调试，优化抛光浆料的配比和硅片的去除量，提升硅片的几何形貌。

目前公司基于翘曲度的控制技术，可实现抛光片翘曲度不超过 18 微米、外延片翘曲度不超过 10 微米，满足国内业界先进制程标准水平。

（三）硅片表面平坦度控制技术

硅片平坦度包含全局平坦度、局域平坦度和纳米形貌，各参数分别从全局和局域定义了硅片表面平坦度的水平，是衡量硅片品质的核心参数之一。硅片全局和局域越平坦，越能满足芯片先进制程的要求。

公司采用三步抛光工艺控制硅片表面平坦度：**1）双面抛光：**调整抛光垫材质和抛光浆料的配比，调整最佳的硅片抛光形貌，优化硅片表面平坦度。同时，对双面抛光设备实施硅片自动化传输接口改造，提升了生产效率；**2）边缘抛光：**以液态化学品与硅片边缘进行化学反应，通过抛光垫和抛光浆料物理机械作用调整硅片边缘形貌，去除前段工艺发生的边缘损伤，降低破片比例；**3）最终抛光：**决定硅片平坦度最核心的步骤。公司通过最终抛光工艺技术可进一步控制硅片表面平坦度、局部平坦度及纳米形貌。此外，通过与设备供应商共同研发，将最终抛光设备与下一步清洗设备实现互连，提升了硅片洁净度和自动化效率。

目前公司基于硅片表面平坦度控制技术，可实现抛光片和外延片产品平坦度均低于 0.35 微米水平，满足国内业界先进制程标准水平。

（四）表面污染控制技术

随着芯片制程的不断升级，对硅片的洁净度提升到近乎苛刻的程度，硅片表面在生产中附带的金属、有机物等颗粒需要控制在极低的水平，否则将严重影响下游晶圆厂的生产良率。

公司表面污染控制技术包含：**1）金属评价：**利用多种检测方式对表面金属、体金属检测，大部分金属最低检测极限可达到每平方厘米内 $1E6$ 个原子数量；**2）清洗技术：**实施清洗设备调试和清洗化学液体配比，通过预清洗、最终清洗两步清洗，结合清洗后的金属检测工序可达到先进制程所要求的超洁净抛光片；**3）流程管控技术：**为防止清洗后硅片的二次污染，在洁净间管控（采用业界最高的 10 级洁净间）、设备供给系统的过滤、杂质监控和工艺流程上都进行了指标跟踪和优化，确保硅片表面品质。

目前，公司针对整体硅片污染的管控可达到万亿分之一的级别，对先进制程要求的16种表面金属原子，抛光片和外延片表面均可控制在每平方厘米硅片仅有5E8个原子以内，和国际同行处于相同水平。表面大于200纳米散射颗粒数量外延片可做到平均每片不高于0.7个，表面大于26纳米的散射颗粒数量抛光片可做到平均每片不高于5.8个，和国际同行处于相同水平。

（五）外延设备基座、反应腔室改善设计

公司外延片主要用于逻辑芯片。相比抛光片，外延片除了对硅片平坦度、洁净度有更高要求，也对外延层厚度、电阻率的均匀性、边缘形貌和纳米形貌有特殊要求。

公司在现有外延设备基础上，自主设计并开发了适用于先进制程的外延设备基座、反应腔等核心部件，结合相匹配的外延层生长工艺，优化外延层的电阻率均匀性、厚度均匀性，提升外延层片的边缘形貌和纳米形貌。

目前公司外延片外延层电阻率均匀性可低于1%，和国际同行处于相同水平。

四、主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：

单位：万元，如无特殊说明

项目	2024/12/31 /2024 年	2023/12/31 /2023 年	2022/12/31 /2022 年
资产总额	1,742,196.67	1,549,762.42	1,534,761.09
归属于母公司所有者权益	851,481.36	922,405.46	938,914.78
资产负债率（母公司）	27.62%	16.08%	12.25%
资产负债率（合并）	51.13%	40.48%	23.65%
营业收入	212,145.26	147,376.14	105,469.31
净利润	-73,764.25	-68,337.45	-53,287.69
归属于母公司所有者净利润	-73,764.25	-57,797.00	-41,182.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-76,255.09	-69,233.88	-41,553.42
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.17	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率	-8.32%	-6.02%	-8.34%

经营活动产生现金流量净额	81,547.82	31,990.45	4,673.76
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入比例	12.20%	11.63%	13.84%

五、发行人存在的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、作为全球 12 英寸硅片新进入“挑战者”，在波动的半导体周期中面临行业固有的投资强度大、技术门槛高、客户认证及正片放量周期长的挑战，报告期内公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利，最近一期期末存在未弥补亏损

报告期各期，公司营业收入分别为 105,469.31 万元、147,376.14 万元和 212,145.26 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 -41,553.42 万元、-69,233.88 万元和 -76,255.09 万元，尚未实现盈利。截至 2024 年末，公司合并报表及母公司未分配利润分别为 -192,750.64 万元和 -49,592.97 万元，存在未弥补亏损。

公司报告期内尚未实现盈利，主要系：1）12 英寸硅片在半导体产业链中单位产能投资强度仅次于晶圆厂。公司第一工厂总投资额高达 110 亿元，已经达产；第二工厂总投资额高达 125 亿元，2024 年已投产，目前主体厂房已整体转固，产线设备陆续转固。报告期内，公司产能持续扩张，固定成本逐年脉冲式增长，产能爬坡带来的阶段性销量不足提高了单位成本。在波动的半导体周期中快速提升收入、释放规模效应、覆盖高额固定成本是公司实现盈利的最大挑战；2）12 英寸硅片目前主要应用于制程更先进、技术迭代更快的逻辑和存储芯片，研发投入需要不断增加。随着芯片制程越先进，线宽越小，12 英寸硅片上极其微小的高度差和颗粒污染都会使芯片布线图发生变形、错位，影响晶圆制造良率。作为新进入“挑战者”，公司不仅需要快速设备调试、产能爬坡、实现达产，持续提升良率和优化成本；同时需契合下游客户技术路线迭代，持续对拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大核心工艺进行研发投入，持续根据客户需求进行产品丰富和升级。针对技术、产品和工艺的刚性研发投入影响公司短期盈利能力；3）12 英寸硅片下游行业集中度高，新进入者需要经历供应商准入、测试片认证、正片认证三个主要阶段方能获取正片量产订单，周期一般 1-2 年甚至更长，高单价正片收入方能开始逐步放量。台积电、三星电子等全球战略级晶圆厂客户，是全球 12 英寸硅片采购主力，认证条件更苛刻，产品要求更高端，叠加复杂的国际环境，公司对全球战略级客户提升收

入规模，尤其是高端产品放量所需的周期更长。

综上，参考国内外友商发展路径，新进入“挑战者”一般需经历 4-6 年的毛利亏损期。报告期内，公司第一工厂和第二工厂计入营业成本的折旧摊销金额合计为 3.20 亿元、6.15 亿元和 9.31 亿元，逐年攀升。随着第二工厂产线陆续转固直至 2026 年达产，可预见 2025 年和 2026 年公司计入营业成本的折旧摊销金额持续增加，进一步增加盈利压力。如果公司持续亏损，对公司发展产生不利影响，也无法对投资者分红。

2、公司研发不能紧跟半导体工艺制程演进和客户技术迭代的风险

目前全球半导体工艺制程最先进的 3 纳米逻辑芯片、1 β 际代 DRAM 和 2YY 层堆叠结构 NAND Flash 均实现量产。遵循“一代技术、一代工艺、一代材料”的规律，下游半导体器件的技术迭代对 12 英寸硅片的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能的要求愈发苛刻。对于同一代工艺制程、不同客户技术路线和指标各有差异，公司需紧跟行业技术路线和客户要求研发相匹配产品，并且持续优化工艺降本增效。此外，公司目前产品主要为 P 型硅片，随着越来越多功率器件由 8 英寸硅片转向 12 英寸硅片，公司对应的 N 型硅片也需进一步研发或客户导入。

截至本上市保荐书签署日，公司产品尚未应用于全球最先进的芯片工艺制程。若公司研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，无法切入全球战略级晶圆厂客户的先进制程工艺，未来经营业绩将受到不利影响。

3、产品结构尚需优化的风险

公司作为新进入“挑战者”，产品需要遵循从测试片到正片逐步认证、依次放量的客观过程。报告期各期，单价和附加值更高的正片主营业务收入占比分别为 53.83%、50.21%和 56.10%。公司正片收入占比对比国际同业仍需进一步提升，产品结构的优化能够提升公司综合销售单价和盈利水平。

正片中的外延片应用于逻辑芯片制造，下游主要为晶圆代工厂。外延片在 12 英寸硅片中单价高、技术难度大、客户认证周期长，尤其是应用于先进制程逻辑芯片的外延片产品。报告期内，由于半导体行业和下游晶圆代工厂需求波动，以及全球前五大厂商与主要晶圆代工厂执行保有最低采购量的长期协议等因素，公司外延片产能利用率尚需提升，单位成本高。报告期各期，公司外延片毛利率分别为-0.84%、-30.31%和 5.47%，虽 2024 年已实现毛利率转正，但仍有较大提升空间。外延片进一步放量需要过程，外

延片占比不足一定程度影响公司目前盈利水平。

如果公司因为自身技术研发、下游客户需求不足或客户认证周期过长，长期无法提升正片及正片中的外延片出货量占比，将对公司经营带来不利影响，从而无法实现 2027 年合并报表盈利的管理层目标。

4、存货跌价风险

报告期内，公司产能持续扩张，存货规模随之匹配，逐年大幅提升，各期末存货账面余额分别为 70,948.86 万元、111,910.53 万元和 124,651.02 万元；2022 年至 2024 年，公司存货周转率分别为 2.03、1.59 和 1.69。鉴于产能持续爬坡，公司产品单位固定成本高，同时叠加行业波动，部分类别产品报告期内存在“负毛利”情况，报告期各期直接计入损益的存货跌价损失分别为 26,681.15 万元、33,184.31 万元和 25,570.48 万元。如果未来公司产品销售价格发生重大不利变化，或者受到第二工厂产能爬坡影响，可能需要进一步计提对应的存货跌价准备，影响公司的盈利水平。

5、控制权稳定风险

本次发行前，控股股东奕斯伟集团直接持股比例为 12.73%，与一致行动人宁波奕芯、重庆奕芯和奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣合三个员工持股平台合计持股比例为 25.68%，不足 30%。本次发行后，控股股东直接持股比例与一致行动人合计表决权比例将被进一步稀释，可能对公司的控制权稳定产生不利影响。

此外，发行人控股股东奕斯伟集团控制的奕斯伟计算已实施多轮股权融资。根据奕斯伟集团与奕斯伟计算现有投资人签署的相关协议约定，特定情形下奕斯伟集团需承担回购投资人股权的义务。目前奕斯伟计算已向香港联交所主板提交 H 股上市申请。根据奕斯伟计算所有股东全票通过的相关股东大会决议，前述奕斯伟集团承担的回购奕斯伟计算股权的义务在提交 H 股上市申请之日的前一日已经中止，将于奕斯伟计算完成 H 股上市时完全终止，但可于奕斯伟计算 H 股上市未果时恢复。若奕斯伟计算 H 股上市未果，且奕斯伟集团没有足额自有或自筹资金，奕斯伟集团存在通过出售发行人股份筹措资金来履行前述回购义务的潜在风险，影响公司的控制权稳定。

6、12 英寸硅片行业未来供需格局均存在不确定性，相关不确定性可能导致公司募投项目第二工厂存在产能无法有效消化风险

供给方面，人工智能驱动全球 12 英寸硅片长期需求，全球 12 英寸硅片友商均积

极规划远期产能。其中，中国大陆友商考虑本土 12 英寸晶圆产能高速扩张以及本土晶圆厂供应链多元化趋势，扩产增速高于全球同业。根据公开信息，截至 2024 年末，国内 12 英寸硅片已投产“名义”产能约 300 万片/月，已规划且可行性较高的在建产能约 100 万片/月。若国内外已规划且可行性较高的产能如期达产，2026 年全球 12 英寸硅片可能呈现阶段性供过于求。

需求方面，鉴于 12 英寸硅片价格尚在筑底、公司在部分客户已量产工艺平台采购份额已达到较高水平、部分客户扩产放缓以及公司产品在部分客户主力工艺平台验证尚未全面量产等客观原因，2024 年公司前五大客户中部分客户收入增速低于当年整体收入增速。12 英寸硅片下游晶圆制造领域市场集中度较高，来自头部客户收入的持续增长是发行人业绩释放的核心。

上述 12 英寸硅片供需不确定性的情况下，若公司下游客户产能扩张不及预期、公司对下游客户所需新产品研发和量产导入进度不及预期、公司维持或提升客户端供应份额的市场策略不及预期、地缘政治等因素制约发行人对海外头部客户供货放量等，可能对公司本次发行募投项目第二工厂的产能消化产生不利影响。若未来供过于求，导致 12 英寸硅片行业产品销售价格持续下行，或发行人第二工厂不具有经济规模的产能利用率，可能无法实现 2027 年合并报表盈利的管理层预期目标。

7、技术人员流失和核心技术泄密风险

公司高度重视对核心技术的保护，与核心人员签署保密协议，且与核心人员签署的劳动合同中包含竞业禁止条款，但仍不排除因核心技术人员流失、员工个人工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密的风险。若上述情形发生，会对公司经营造成不利影响。

8、客户集中度高的风险

由于下游晶圆厂行业集中度较高，报告期各期公司合并口径前五大客户营业收入当期占比均超过 60%。公司客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位，且公司的经营业绩与下游晶圆厂的产能利用率密切相关，客户自身经营状况变化也可能对公司产生较大的影响。如果公司后续不能持续开拓新客户或对少数客户形成重大依赖，将不利于公司持续稳定发展。

9、无法有效开拓全球战略级晶圆厂客户的风险

目前 12 英寸硅片下游客户主要为存储 IDM 厂商及逻辑晶圆代工厂。目前全球 NAND Flash 和 DRAM 领域中三星电子、SK 海力士等厂商占据 90%以上市场份额；晶圆代工领域，台积电占据全球 50%以上的市场份额。前述均为公司需要服务的全球战略级客户，其对 12 英寸硅片的认证条件苛刻、议价能力强，并与全球前五大厂商常年合作，甚至双方签署确保最低采购量的长期协议。如公司无法通过全球战略级客户正片认证，或无法切入相应客户的先进制程工艺研发，或无法持续提升相应客户的采购占比，将对公司 2026 年消化第一和第二两个工厂产能造成挑战，不利于公司长期经营发展。

10、汇率波动风险

报告期内，公司部分原材料和设备从境外进口，部分产品出口销售，相应进口采购和外销均以外币结算，汇率波动对公司经营业绩的影响较大。报告期各期，公司汇兑损失分别为 2,319.53 万元、-73.81 万元和-1,867.04 万元。随着公司境外采购、出口销售规模不断扩大，如果未来人民币对主要结算外币的汇率波动加剧或者汇率政策发生重大变化，将对公司业绩产生一定的影响。

11、规模增长带来的管理风险

报告期内，随着公司第一工厂达产和第二工厂建设，公司的业务体量和资产规模不断扩张，相应的在研发、采购、生产、销售和信息化等环节的资源配置和内控管理的复杂程度也在不断提升，对公司组织架构和管理层的挑战和能力要求不断加强。若公司的组织模式和经营管理制度未能随着公司业务规模的扩大及时调整与完善，未能建立起有效的多工厂运营模式，公司将面临规模扩张导致的管理和内控风险，从而给公司的稳定发展带来不利影响。

（二）与行业相关的风险

1、公司服务全球客户，面对全球前五大厂商在 12 英寸硅片领域多年寡头垄断竞争格局的风险以及国内厂商同台竞争的风险

2024 年，全球 12 英寸硅片约 80%的出货量来自全球前五大厂商，寡头垄断格局已持续多年。作为新进入“挑战者”，与国际同业相比，公司在产能规模、产品品类、下游产品制程先进性和客户议价能力等方面存在一定差距。尤其是全球前五大厂商开展 12 英寸硅片业务大多早于公司 15 年以上，已经与下游台积电、三星电子等全球战略级

晶圆厂客户形成稳定合作关系（包括但不限于签订确保最低采购量的长期协议、优先参与客户更先进制程晶圆工艺的研发等）；对于上游电子级多晶硅、石英制品和硅片工艺设备等核心设备和材料供应商，甚至具有控股或参股的投资关系。同时，国际友商对硅晶体的基础理论研究、晶体生长和硅片加工具有深厚的技术底蕴，建立了森严的专利技术壁垒，具有技术先发优势。此外，相应厂商前期高额的设备投入部分已折旧完毕，固定成本压力小，生产工艺相对成熟，良率相对稳定，已实现规模效应，且正片及正片中的外延片出货量占比更高，具有较好的盈利能力。

此外，部分国内友商起步早于发行人，随着长期研发和产能投入，已形成一定市场规模，与发行人共同提升 12 英寸硅片本土化率。

面对全球和国内竞争，若公司不能有效开拓全球战略级客户、增强资本实力、持续提升产能和收入规模、提升正片和正片中外延片比例、夯实技术储备，将与全球前五大厂商的差距进一步拉大，将无法与国内友商进一步拉开竞争身位，可能导致公司市场竞争力下降，无法实现公司的经营战略和业绩目标。

2、国际贸易摩擦的风险

报告期内，公司采购的部分原材料和生产设备主要来自日本、韩国、美国等国家厂商。同时，公司产品已向中国台湾、日本、美国、新加坡等地客户批量供货，报告期各期，公司外销主营业务收入占比稳定在 30%左右。

受国际贸易摩擦影响，部分国家或地区对中国大陆原产的特定品类 12 英寸硅片实施进口限制或设置贸易壁垒，影响公司特定产品在特定国家或地区销售，影响公司部分原材料和生产设备的进口采购。上述情况经过评估和测算，对公司盈利预测期业绩达成影响有限。

对于公司部分下游客户，其获取更先进制程或特定规格的半导体用技术、软件、材料和设备等生产要素的能力受到影响，导致其产能扩张和工艺制程迭代放缓，可能对发行人销售产生不利影响。

若国际贸易摩擦进一步升级，如大幅提升关税、公司产品出海被限制，或难以切入海外战略级晶圆厂客户先进制程工艺，可能对公司经营和业绩带来重大不利影响，从而无法实现 2027 年合并报表盈利的管理层目标。

3、知识产权争议风险

公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研发过程中，涉及到的专利及非专利技术等知识产权众多，需通过申请专利等方式保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权。但不能排除与竞争对手等相关方产生知识产权争议的可能性，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的可能性，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。

4、政府补助与税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司获得一定规模政府补助。报告期各期，政府补助确认的其他收益金额分别为 1,136.04 万元、1,817.45 万元和 3,490.25 万元。如果未来相关政府部门对公司所处行业的政策支持力度调整或其他产业政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额可能有所降低，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。

所得税方面，公司及部分子公司为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税的优惠税率。增值税方面，根据国家有关政策，公司及部分子公司报告期内享受增值税留抵税额返还、出口退税以及增值税加计抵减的税收优惠。未来如果相应税收优惠政策发生不可预测的调整，或者公司不能持续获得高新技术企业资质认定，公司的盈利能力和资金周转能力将受到影响。

（三）其他风险

除上述风险因素外，投资者在评价公司本次发行的股票时，还应特别认真地考虑整体变更存在未弥补亏损风险、发行失败风险、募投项目实施效果未达预期的风险、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险、股票价格可能发生较大波动的风险、安全生产、环境保护、不可抗力等风险。

第二节 本次证券发行情况

一、本次证券发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数及占发行后总股本比例	本次初始发行的股票数量为 53,780.00 万股，不涉及股东公开发售股份，约占初始发行后股份总数的 13.32%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权的发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15.00%
保荐机构	中信证券股份有限公司
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和上交所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

中信证券指定张欢、陈泽作为奕斯伟材料首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

张欢，男，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括沈阳富创精密设备股份有限公司 IPO 项目、有研半导体硅材料股份有限公司 IPO 项目、中信金属股份有限公司 IPO 项目、长江存储科技有限责任公司财务顾问项目、中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 IPO 项目、山东新巨丰科技包装股份有限公司 IPO 项目、江苏共创人造草坪股份有限公司 IPO 项目、天津七一二通信广播股份有限公司 IPO 项目、中铝国际工程股份有限公司 IPO 项目、厦门钨业股份有限公司非公开发行股票项目、武汉华中数控股份有限公司非公开发行股票项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票项目、中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产并配套融资项目、中金黄金股份有限公司配股项目、中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票项目、中国石油化工股份有限公司销售板块引战混改项目、中信证券（浙江）分立重组项目等 A 股项目以及山东天岳先进科技股份有限公司 H 股 IPO 项目、北京奕斯伟计算技术股份有限公司

H 股 IPO 项目、徽商银行股份有限公司 H 股 IPO 项目、昆山丘钛微电子科技股份有限公司港股 IPO 项目、中国信达资产管理股份有限公司 H 股 IPO 项目等港股项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈泽，男，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与南京莱斯信息技术股份有限公司 IPO 项目、南京高华科技股份有限公司 IPO 项目、晶晨半导体（上海）股份有限公司 IPO 项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票项目、本钢板材股份有限公司可转债项目、长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票项目、安通控股股份有限公司非公开发行股票项目、览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票项目、上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票项目、北京君正集成电路股份有限公司发行股份购买资产及配套融资项目、冠福控股股份有限公司发行股份购买资产及配套融资、厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产及配套融资项目、河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

中信证券指定赵悠作为奕斯伟材料首次公开发行股票并在科创板上市项目协办人。

赵悠，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与了宁波容百新能源科技股份有限公司科创板 IPO 项目、江苏共创人造草坪股份有限公司 IPO 项目、海特克动力股份有限公司 IPO 项目、中电科思仪科技股份有限公司科创板 IPO 项目、山东天岳先进科技股份有限公司 H 股 IPO 项目、北京奕斯伟计算技术股份有限公司 H 股 IPO 项目、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2019 年重大资产重组项目、金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转债项目、武汉华中数控股份有限公司非公开发行项目、南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行项目、中航光电科技股份有限公司非公开发行项目、航天时代电子技术股份有限公司非公开发行项目、浙江零跑科技股份有限公司内资股增发项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括马峥、赵凡、袁震、卢珂、魏开元、陈骥腾、华

文扬、吴啸、金浩、马奕桐、周靖轩、张锦沛、于棚土、糜泽文、王旭东（已离职）、胡一了（已离职）、李龙飞（已离职）。

（四）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员执业情况联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话：010-6083 6812

三、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，中信证券全资子公司中证投资持有发行人 2.20%股份，同时是持有发行人 3.50%股份的中建材新材料基金的出资比例约 0.67%的有限合伙人。长峡金石的执行事务合伙人长峡金石（武汉）私募基金管理有限公司的控股股东和川投金石的执行事务合伙人均为中信证券全资子公司金石投资有限公司，长峡金石、川投金石分别持有发行人 1.32%、0.73%股份。

截至本上市保荐书签署日，中信证券全资子公司中证投资持有发行人重要关联方奕斯伟计算 0.8239%股份，中信证券全资子公司金石投资有限公司作为执行事务合伙人的无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）持有奕斯伟计算 1.4730%股份。

除此之外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

此外，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求，科创板试行保荐人相关子公司“跟投”制度。保荐人将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，除中信银行股份有限公司为发行人提供常规的银行业务服务外，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐机构内部审核具体程序如下：

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 $2/3$ 以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）内部审核意见

2024 年 8 月 13 日，在中信证券大厦 11 层 19 号会议室召开了奕斯伟材料项目内核会，内核委员会对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将奕斯伟材料项目申请文件对外申报。

第三节 保荐人承诺事项

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信证券作出以下承诺：

一、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

二、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

四、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

五、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

六、保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

八、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受上海证券交易所的自律监管。

九、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

十、保荐人将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，自愿接受证券交易所的自律监管。

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见

一、推荐意见

中信证券根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。

发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2023年7月11日、2024年5月28日和2024年11月8日，发行人分别召开了第一届董事会第四次会议、第一届董事会第六次会议和第一届董事会第八次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

（二）股东大会决策程序

2023年7月26日、2024年6月17日和2024年11月13日，发行人分别召开了2023年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合科创板定位要求

（一）发行人符合技术先进性要求

公司围绕主营业务建立了完备的核心技术体系，覆盖 12 英寸硅片生产的所有工艺环节。保荐人关于发行人符合技术先进性要求的核查程序及核查结论如下：

1、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）通过与公司主要管理人员、核心技术人员、研发部门负责人进行访谈，了解了发行人核心技术主要内容、应用情况、技术先进性水平等情况；

（2）开展客户供应商走访，了解发行人产品技术的市场口碑、行业地位、先进性水平；

（3）获取了发行人资质、许可有关证书，分析了与主营业务的联系；

（4）获取了发行人报告期内所获重要奖项的奖状或证明文件；

（5）通过与公司主要管理人员、核心技术人员、研发部门负责人进行访谈，了解发行人所承担的重大科研项目、主要科研成果、科研实力等情况。

2、核查结论

保荐机构对发行人研发的技术及其功能性能、取得的研发进展及其成果、获得的专业资质和主要奖项等进行核查。

经核查，保荐机构认为：发行人拥有和应用的技术具有先进性，符合科创板定位及相关要求。

（二）发行人符合科创板支持方向

12 英寸硅片行业是国家基础性和战略性新兴产业，保荐机构关于发行人符合科创板支持方向的核查程序及核查结论如下：

1、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）通过与公司主要管理人员、核心技术人员访谈，了解了发行人主营业务开展

情况、主要产品和服务内容、主要核心技术等情况；了解了国家科技创新战略与发行人所处行业的联系，对发行人生产经营的影响和要求；了解了发行人所处行业重要发展趋势，发行人所处市场地位等情况；

（2）查阅了发行人研发相关内部制度文件，通过公司访谈了解了发行人在研项目的开展情况及与主营业务的联系。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为：发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的符合科创板支持方向。

（三）发行人符合科创行业领域要求

公司属于科创板重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业，符合科创板的行业定位要求，公司所属行业分类情况如下：

公司所属 行业领域	☒ 新一代信息技术	根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属行业领域属于“鼓励类”第二十八条第 4 款“集成电路”中包含“线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产）”
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	根据《国民经济行业分类》，公司所属行业领域属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C3985）
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023 年 5 月）》，公司所处行业为“C 制造业”之“CH 电气、电子及通讯”之“CH39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“CH398 电子元件及电子专用材料制造”

1、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）与公司主要管理人员进行了访谈，了解公司生产经营、产品技术、发展战略等情况；

（2）获取了公司主要采购及销售合同，了解公司客户及供应商情况，并对公司主要客户与供应商进行了走访，了解公司经营模式；

（3）收集并审阅了行业研究报告及竞争对手公开披露信息；

(4) 查阅了相关权威产业分类目录，了解行业信息和公司业务定位。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为：

发行人所属行业属于科创板重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条，符合科创板的行业定位要求。发行人主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

(四) 发行人符合科创属性相关指标要求

首先，2022 年至 2024 年，公司累计研发投入为 57,623.25 万元，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上”标准。

其次，公司营业收入从 2022 年的 10.55 亿元增至 2024 年的 21.21 亿元，复合增长率达到 41.83%，符合《科创属性评价指引（试行）》中“最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元。”标准。

第三，公司研发活动分为技术研发、产品研发、工艺研发、设备及系统研发四大类。其中产品研发需要新产品导入量产，工艺研发需要针对产线已有工艺流程、方法和配方不断优化，鉴于发行人并无专用的研发产线，研发活动与生产活动存在共用设备情形，从而发行人存在非全时研发人员。截至 2024 年末，公司拥有研发人员 235 人，人数占比约 12%，其中全时研发人员 115 人，非全时研发人员 120 人，符合《科创属性评价指引（试行）》中“研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%”标准。

第四，截至 2024 年末，公司已获授权发明专利合计 539 项。按照严格标准，剔除海内外同族专利、共有专利、无法对应公司五大工艺或未涉及已披露核心技术的专利以及尚未产生经济效益、业内尚未应用但公司提前储备的专利后公司应用于主营业务、形成核心技术并且能够产业化的发明专利共计 108 项，符合《科创属性评价指引（试行）》中“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上”的标准，也高于《科创属性评价指引（试行）》中例外条款的第五条“形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上”标准。

1、核查程序

保荐机构履行了如下核查程序：

（1）与公司主要管理人员和研发部门负责人进行了访谈，查阅了公司研发管理相关管理制度，对报告期内公司的研发费用归集政策等进行核查，获取了公司报告期内研发费用明细表；

（2）与公司主要管理人员和人力资源部门负责人进行了访谈，了解了公司研发活动开展情况，获取了员工名册，复核了研发人员统计情况；

（3）与公司主要管理人员和研发部门负责人进行了访谈，了解了发行人专利相关信息，获取了公司专利证书，了解了各项专利在主要产品和服务中的应用情况，并公开查询了发行人专利权属及纠纷情况；

（4）与公司管理层、财务部门负责人等进行访谈，核查了报告期内公司的收入确认政策，了解了主要经营情况，获取了收入明细表，查阅了发行人与主要客户签订的相关合同及相关产品出库单、签收单、银行付款凭证等，向发行人主要客户进行了访谈及函证，并对报告期各期末进行了收入截止性测试，获取了公司报告期内的营业收入情况；

（5）与公司主要管理人员、生产部门负责人、研发部门负责人进行了访谈，了解了发行人依靠核心技术形成的主要产品情况。

2、核查结论

经核查，保荐机构认为：

发行人最近三年累计研发投入真实、准确，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条之（一）。

发行人研发人员占比之情况真实、准确，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条之（二）。

发行人形成核心技术和主营业务收入的发明专利数量真实、准确，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条之（三）、第七条之（五）。

发行人营业收入真实、准确，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条之（四）。

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

本保荐人依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

奕斯伟材料股票上市符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：

（一）发行人符合证监会规定的发行条件

1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人的发起人协议、公司章程、发行人工商档案、《营业执照》等有关资料，保荐人认为，发行人系根据《公司法》在中国境内设立的股份有限公司，发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、验资、工商注册及变更登记等手续，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司。经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人于 2016 年 3 月 16 日完成有限责任公司法人主体前身的设立，并于 2023 年 3 月 15 日整体变更为股份有限公司，保荐人认为，发行人持续经营时间已在 3 年以上。

经核查发行人历次股东大会、董事会和监事会的会议文件，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理（总裁）工作细则》等制度，发行人自设立为股份有限公司以来已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设置了战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会，并建立了《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度。保荐人认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的

可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度以及毕马威会计师出具的标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2507188 号”《审计报告》，并核查发行人的原始财务报表，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

根据发行人的财务管理制度和内部控制制度、毕马威会计师出具的“毕马威华振审字第 2507533 号”《内部控制审计报告》，并核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标、计算机软件著作权等资料，并结合对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料。保荐人认为，发行人资产完整，资产、人员、财务、机构、业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查发行人历次股东大会、董事会会议文件，并核查发行人的实际经营情况，保荐人认为，发行人最近二年内主营业务为 12 英寸硅片的研发、生产及销售，主营业务没有发生重大变化。

经核查发行人历次聘请董事、高级管理人员的股东会决议及董事会决议，发行人最近二年内董事、高级管理人员没有发生重大不利变化。

自公司成立以来，控股股东和实际控制人所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈，并根据竞天公诚出具的《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、社会保障及住房公积金等方面的主管机构出具的有关证明文件，并进行公开信息查询，保荐人认为，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事、监事和高级管理人员的个人简历、无犯罪记录证明及其分别出具的相关承诺，并核查股东大会、董事会、监事会运营记录，公司董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

（二）本次发行后公司的股本总额不少于人民币 3,000 万元

（三）公司股本总额超过人民币 4 亿元，本次公开发行的股份不低于奕斯伟材料本次发行后股份总数的 10%

（四）市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准

根据毕马威会计师事务所出具的标准无保留意见的“毕马威华振审字第 2507188”《审计报告》，公司 2024 年度实现营业收入 21.21 亿元，并参照 2023 年 5 月发行人报告期第五次增资（CII 轮融资）投后估值为 200.05 亿元。公司的预计市值及财务指标满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准中的“（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

（五）发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件

综上所述，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第五节 上市后持续督导工作安排

- 一、持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；
- 二、有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、上海证券交易所报告；
- 三、按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；
- 四、督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
- 五、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；
- 六、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
- 七、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
- 八、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
- 九、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
- 十、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

保荐代表人：

张欢
张 欢

陈泽
陈 泽

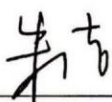
项目协办人：

赵悠
赵 悠

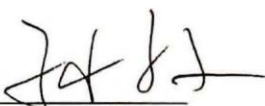


（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

内核负责人：


朱 洁

保荐业务负责人：


孙 毅



2025 年 8 月 15 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：


张佑君

中信证券股份有限公司

2025 年 8 月 15 日